

2-3-1-2 SR 装置接触跡／SR 接触装置の痕迹／Equipment contact mark on solder resist

【特徴】SR 表面に規則正しいピッチの同一形状接触痕跡が見られる状態の欠陥

【特征】在 SR 表面出现有规则的间距相同的接触痕迹的缺陷。

【Characteristics】Contact marks of the same shape are left on the solder resist surface with a constant interval.

【原因・判断ポイント・発生工程】SR 表面に製造装置の一部が断続的に触れて出来たもの（SR 塗布乾燥後のコンベア搬送工程）

【原因、判断要点、发生工序】SR 表面断续地接触制造装置的局部所引起的（SR 后的传送工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】The defect is caused by intermittent contact of a part of the manufacturing equipment with the solder resist surface, (Transportation process after solder resist application)



【コメント】顕微鏡倍率 ×

【注釋】显微镜倍率 ×

【Comments】Magnification: ×



【コメント】顕微鏡倍率 ×

【注釋】显微镜倍率 ×

【Comments】Magnification: ×

2-3-1-3 SR 下地研磨傷／SR 基底的磨伤／Abrasion mark on basis metal under solder resist

【特徴】SR 下地導体表面に深めの研磨傷が見え商品価値を損ねている状態の欠陥

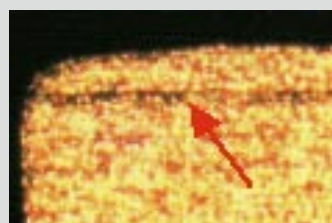
【特征】在 SR 基底的导线面可见较深的磨伤，有损商品价值的缺陷。

【Characteristics】A slightly deep abrasion mark is observed on the surface of the basis conductor under solder resist, which reduces the commercial value of the product.

【原因・判断ポイント・発生工程】導体研磨時に、何らかの要因により深めの研磨傷が出来、SR 塗布によりその傷が目立つようになって出来たもの（導体研磨～SR 塗布工程）

【原因、判断要点、发生工序】导线在研磨时，某种原因造成较深的磨伤，在涂布 SR 后该伤痕明显地显露出来所引起的（导线研磨～涂布 SR 工序）。

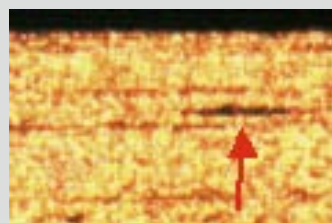
【Causes/processes involved/keys to judgment】A slightly deep abrasion mark is formed on the conductor by some reason at the time of surface abrasion and the coated solder resist makes the mark more apparent, causing the defect. (Conductor abrasion - solder resist application process)



【コメント】顕微鏡倍率 ×

【注釋】显微镜倍率 ×

【Comments】Magnification: ×



【コメント】顕微鏡倍率 ×

【注釋】显微镜倍率 ×

【Comments】Magnification: ×